

附件一

## 电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共6项，其中自主可控 A 级0项、B 级6项、C 级0项、C\*级0项、D 级0项、E 级0项；伪国产化0项、包装国产化0项、空心国产化0项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表一

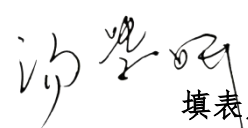
电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

| 序号 | 元器件名称 <sup>a</sup> | 型号规格 <sup>b</sup> | 生产厂商 <sup>c</sup> | 自主可控等级 <sup>d</sup> | 是否“伪国产化” <sup>e</sup> |      | 是否“包装国产化” <sup>e</sup> |      | 是否“空心国产化” <sup>e</sup> |      | 备注 <sup>f</sup> |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|-----------------|
|    |                    |                   |                   |                     | 是/否                   | 情况说明 | 是/否                    | 情况说明 | 是/否                    | 情况说明 |                 |
| 1  | 模拟开关               | JTLX2233YS16      | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 2  | 模拟开关               | JTLX2233YSS16     | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 3  | 模拟开关               | JTLX2233YTSS16    | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 4  | 模拟开关               | TLX2233YS16       | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 5  | 模拟开关               | TLX2233YSS16      | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 6  | 模拟开关               | TLX2233YTSS16     | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |

填表说明：

- <sup>a</sup>. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- <sup>b</sup>. 应填写元器件完整型号规格；
- <sup>c</sup>. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- <sup>d</sup>. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C\*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
- <sup>e</sup>. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- <sup>f</sup>. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。

填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）：

电话：18221090182

填报日期：20250617

附表二

电子元器件基本信息表

| 序号 | 元器件名称 <sup>a</sup> | 型号规格 <sup>b</sup> | 使用 IP 核情况 <sup>c</sup> |    |      |       | 原材料和零部件 <sup>d</sup> |                          |                   |       | 流片工艺 <sup>e</sup> |       | 备注 |
|----|--------------------|-------------------|------------------------|----|------|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|----|
|    |                    |                   | 名称                     | 类型 | 来源单位 | 境内/境外 | 名称                   | 是否“核心”/“关键” <sup>e</sup> | 来源单位 <sup>f</sup> | 境内/境外 | 工艺名称              | 境内/境外 |    |
| 1  | 模拟开关               | JTLX2233YS16      | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5 CMOS          | 境内    |    |
|    |                    |                   | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 天水华天              |       |                   |       |    |
| 2  | 模拟开关               | JTLX2233YSS16     | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5 CMOS          | 境内    |    |
|    |                    |                   | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 天水华天              |       |                   |       |    |
| 3  | 模拟开关               | JTLX2233YTSS16    | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5 CMOS          | 境内    |    |
|    |                    |                   | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 天水华天              |       |                   |       |    |
| 4  | 模拟开关               | TLX2233YS16       | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5 CMOS          | 境内    |    |
|    |                    |                   | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 天水华天              |       |                   |       |    |
| 5  | 模拟开关               | TLX2233YSS16      | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5 CMOS          | 境内    |    |
|    |                    |                   | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 天水华天              |       |                   |       |    |
| 6  | 模拟开关               | TLX2233YS16       | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5 CMOS          | 境内    |    |
|    |                    |                   | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 天水华天              |       |                   |       |    |

填表说明：

<sup>a</sup>. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

<sup>b</sup>. 应填写元器件完整型号规格

填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填报人（签字）

电话：

填报日期：20250617

- <sup>c</sup>. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- <sup>d</sup>. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- <sup>e</sup>. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- <sup>f</sup>. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- <sup>g</sup>. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）

电话：

填报日期：20250617

汤黎明

姜春雷

18221090182